



氣相分解金屬污染收集設備（VPD）

Seehund® 系列

氣相分解金屬污染收集設備 (VPD)

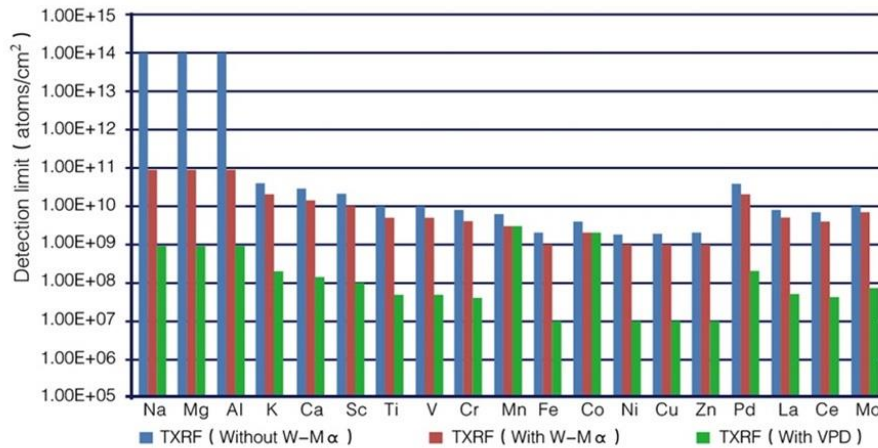


系統特性

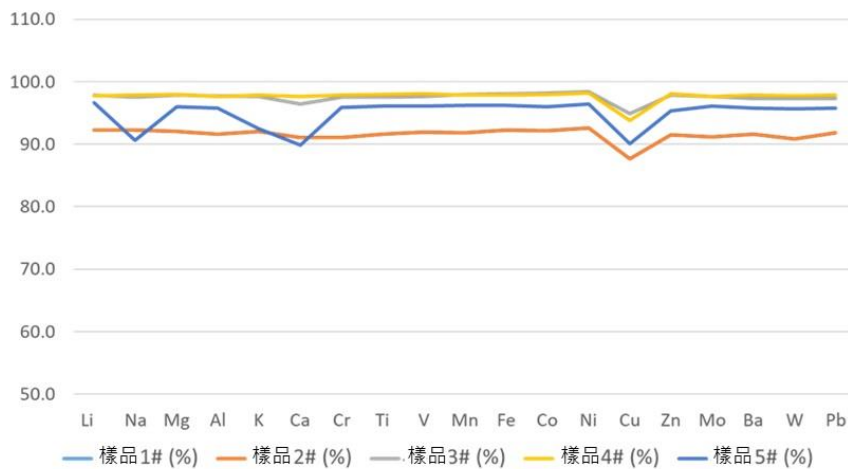
- ◆ 相容於 8 吋 / 12 吋晶圓
- ◆ 適用於 IC 製造、晶圓製造及晶圓回收過程中的金屬污染監測
- ◆ 配合載具可相容於 6 吋晶圓
- ◆ 可搭配電感耦合等離子體質譜儀 (ICP-MS) 或全反射螢光光譜分析儀 (TXRF) 使用
- ◆ VPD 與 ICP-MS 或 TXRF 組合，可將檢測靈敏度提高 2 個級距，滿足上述領域的微量金屬污染及監控需求

測試數據

VPD可將檢測靈敏度提升兩個級距



元素收集率測試：VPD & ICP - MS



詳細介紹

Seehund® 系列氣相分解金屬污染收集設備 (VPD) 是專為積體電路製造、大晶圓生產及晶圓回收過程中的金屬污染監測方案的產品。由於目前的晶圓製造產業對金屬污染控制的要求已經遠遠低於 TXRF 和 ICP-MS 能夠測量的極限，需要採用 VPD 對晶圓表面污染做大量蒐集，才能突破檢測靈敏度極限，滿足晶圓產線的需求。該設備採用了 12 吋及 8 吋晶圓產線設備所通用的國際標準零件，符合 SEMI 的設計標準，並經過了嚴格的穩定性和可靠性測試驗證。